

[进入PCB/激光钢网下单系统] (/consumer/login.html)

[进入立创元器件商城网站] (http://www.szlsc.com/)

[进入立创社区] (http://club.szlsc.com)

[电信入口] (http://dx.sz-jlc.com)

[联通入口] (http://lt.sz-jlc.com)

[移动入口] (http://yd.sz-jlc.com)

[添加到收藏夹] (JavaScript:window.external.AddFavorite('http://www.sz-jlc.com', '深圳市嘉立创科技发展有限公司-pcb线路板打样');)

(/home/index.html)

新

PCB首页 (/home/index.html)

在线计价 (/home/vorderadd.html)

工厂参观 (/home/vfactory.html?factory)

产品展示 (/home/vproduct.html?smt)

工艺参数 (/home/vtechnology.html)

SMT打样 (/home/newV2/smt.jsp)

下单流程 (/home/newV2/place.jsp)

关于我们 (/home/vcontact.html?1)

立创社区 (http://club.szlsc.com)

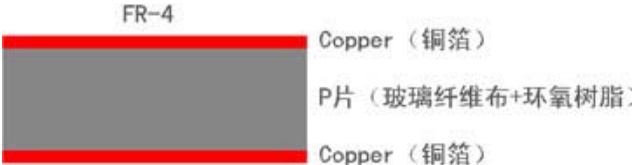
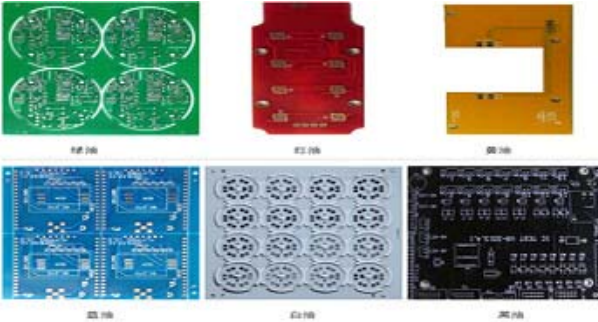
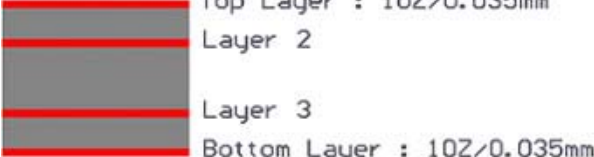
PCB/电路板打样首选嘉立创

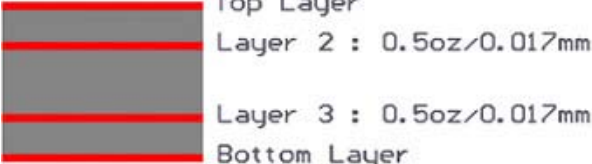
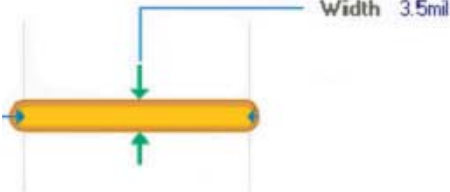
10年行业专业经验

THE FIRST CHOICE OF THE PCB/ CIRCUIT BOARD IS JIA LICHUANG
TEN YEARS' PROFESSIONAL EXPERIENCE IN INDUSTRY

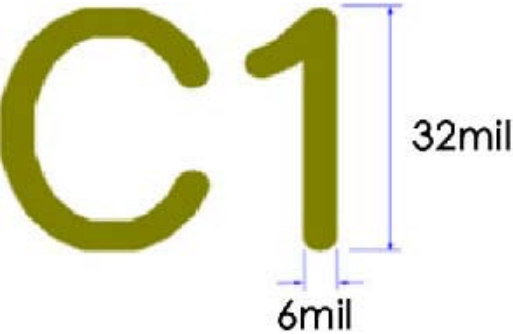
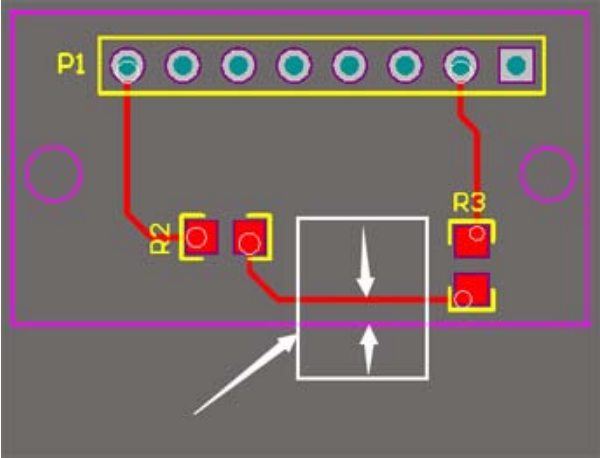
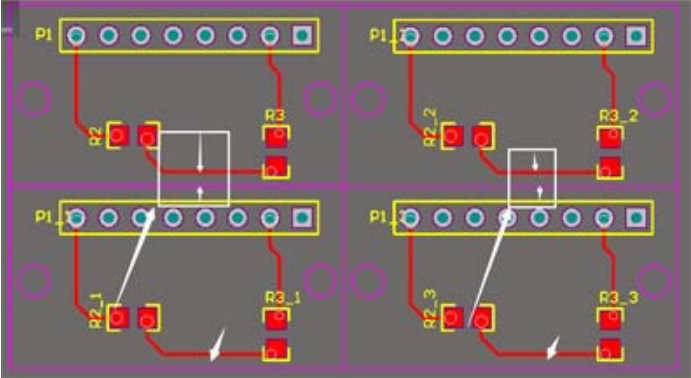
工艺参数

项目	加工能力	工艺详解	图解
层数	1~6层	层数，是指PCB中的电气层数（敷铜层数）。目前嘉立创只接受1~6层板	

项目	加工能力	工艺详解	图解
多层板阻抗	4层，6层	嘉立创2018年多层板支持阻抗设计，阻抗板不另行收费	嘉立创阻抗多层板：层压结构及参数 (http://club.szlcsc.com/article/details_11533_1.html) 嘉立创阻抗条现场测试图 (http://club.szlcsc.com/article/details_11485_1.html)
板材类型	FR-4板材	板材类型：纸板、半玻纤、全玻纤（FR-4）、铝基板，目前嘉立创只接受FR-4板材。如右图	
采用生产工艺	FR-4板材	传统镀锡工艺正片	灾难性的负片工艺再出江湖，用此工艺为品质灾难，详情 www.sz-jlc.com/home/t7i1278.html (/home/t7i1278.html)
最大尺寸	40cm * 50cm	嘉立创开料裁剪的工作板尺寸为40cm * 50cm，通常允许客户的PCB设计尺寸在38cm * 38cm以内，具体以文件审核为准。	
阻焊类型	感光油墨	感光油墨是现在用得最多的类型，热固油一般用在低档的单面纸板。如右图	
成品外层铜厚	1oz~2oz (35um~70um)	默认常规电路板外层铜箔线路厚度为1oz，最多可做2oz（需下单备注说明）。如右图	以四层板为例， 

项目	加工能力	工艺详解	图解
成品内层铜厚	0.5oz (17um)	默认常规电路板内层铜箔线路厚度为0.5oz。如右图	<div>以四层板为例，</div> 
外形尺寸精度	±0.2mm	板子外形公差±0.2mm。	
板厚范围	0.4~2.0mm	嘉立创目前生产板厚： 0.4/0.6/0.8/1.0/1.2/1.6/2.0 mm。	
板厚公差 (T≥1.0mm)	± 10%	比如板厚T=1.6mm，实物板厚为 1.44mm (T - 1.6×10%) ~1.76mm (T + 1.6×10%)	
板厚公差 (T<1.0mm)	±0.1mm	0.7mm (T-0.1) ~0.9mm (T+0.1)	
钻孔孔径 (机械钻)	0.2~6.3mm	最小孔径0.2mm，最大孔径6.3mm，如果大于6.3mm工厂要另行处理。机械钻头规格为0.05mm为一阶，如0.2，0.3m	<div>Minimum 0.2mm Maximum 6.3mm</div> 
孔径公差 (机器钻)	±0.08mm	钻孔的公差为±0.08mm， 例如设计为0.6mm的孔，实物板的成品孔径在0.52--0.68mm是合格允许的。	
线宽	3.5mil	多层板3.5mil 单双面板5 mil	

项目	加工能力	工艺详解	图解
线隙	3.5mil	多层板3.5mil 单双面板5 mil	
最小过孔内径 及外径	内径(hole)最小0.2mm,外径(diameter)最小0.45mm	多层板最小内径0.2mm，最小外径为0.45mm，双面板最小内径0.3mm,最小外径0.6mm	
焊盘边缘到线距离	5mil	参数为极限值，尽量大于此参数	
过孔单边焊环	3mil	参数为极限值，尽量大于此参数	

项目	加工能力	工艺详解	图解
最小字符宽	线宽6mil 字符高32mil	参数为极限值，尽量大于此参数	
单片出货：走线和焊盘距板边距离	≥0.2mm	否则可能涉及到板内的线路及焊盘	
拼版V割出货：走线和焊盘距板边距离	≥0.4mm	否则可能涉及到板内的线路及焊盘,如右图，如果是拼版，则线离边必须要有0.4mm间距，否则v割会伤到线路。如果是单片出货，则需要帮≥0.2mm的间距。	

项目	加工能力	工艺详解	图解
最小工艺边	3mm		
拼板：无间隙拼板	0mm间隙拼板	板子与板子的间隙为0mm。点击查看大图 (/images/zuix_gyzs_b30-858b43877d.jpg)	
拼板：有间隙拼板	1.6mm间隙拼板	有间隙拼版的间隙不要小于2.0mm，否则锣边时比较困难。点击查看大图 (/images/zuix_gyzs_b33-04969d5275.jpg)	
半孔工艺最小孔径	0.6mm	半孔工艺是一种特殊工艺，最小孔径不得小于0.6mm。小于0.6MM做不出半孔的效果	
阻焊层开窗	0.05mm	绿油桥小于3mil不保留，绿油桥大于3mil保留,不以阻焊桥为检验出货标准	
注意事项1： Pads厂家铺铜方式	Hatch方式铺铜	厂家是采用还原铺铜（Hatch），PADS软件设计的客户请务必注意。如右图	
注意事项2： Pads软件中画槽	用Outline线	如果板上的非金属化槽比较多，请用outline画	

[关于我们 \(/home/vcontact.html\)](/home/vcontact.html) | [产品中心 \(/home/vproduct.html\)](/home/vproduct.html) | [服务与支持 \(/home/vcontact.html?1\)](/home/vcontact.html?1) | [下载中心 \(/home/appDownloadsWithConfig.html?](/home/appDownloadsWithConfig.html?init=pc&x=0.42017755101209686)

[init=pc&x=0.42017755101209686\)](#)

联系方式：0755 - 82048201/82048204 QQ:800005884(售后) 传真：0755-82048202

公司地址：深圳市福田区商报路奥林匹克大厦27楼

集团旗下事业部： PCB事业部 (</home/index.html>) | 激光钢网事业部 (<http://www.jlc-gw.com/>) |

友情链接： 立创元器件商城 (<http://www.szlsc.com/>) | 立创工程师社区 (<http://club.szlsc.com>) | 立创EDA (<https://lceda.cn>) | 手机网页版 (</phone/index.html?s=a>)



版权所有·深圳市嘉立创科技发展有限公司 粤ICP备11084592号-1 (<http://www.miitbeian.gov.cn>)